

证券代码：000016，200016

证券简称：深康佳 A、深康佳 B

## 康佳集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-18

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话调研）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024年12月12日（周四）下午 14:30—17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员	1、党委书记、董事局副局长（主持工作）周彬 2、独立董事邓春华 3、财务总监聂勇 4、董事局秘书李春雷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、问：鉴于公司当前的经营状况，管理层对于股东的回报政策有何调整计划？是否会继续高分红政策？</p> <p>答：你好，谢谢你的关注。公司将在积极改善经营业绩的同时，结合经营情况和业务发展目标制定积极稳定的分红政策回报广大投资者。</p> <p>2、问：2024年深康佳A的现金流状况如何？公司是否有足够的流动资金来支持未来的运营和发展？</p> <p>答：你好，谢谢你的关注。公司正在持续优化债务结构及融资成本，并通过资产盘活回笼资金，深化资金精益管理。截至2024年第三季度末，公司货币资金为40亿元。</p> <p>3、问：公司已经连续三年亏损，请问什么时候能够做到盈利？</p> <p>答：你好，谢谢你的关注。公司将以“一轴两轮三驱动”新发展战略为指引，坚持长期价值主义，坚持立足长远、先专后强的经营策略，深化专业化整合，实施精益化管理，并将把资源用于保障主业发展，聚集资源推动白电及PCB产业的规模增长及利润提升，精益管理推进彩电业务价值经营及减亏控亏，创新实施半导体业务的资本化及效益化产出，积极改善经营业绩。</p>

4、问：深康佳A在 2024 年的研发投入情况如何？公司是否有重要的研发成果或专利申请？

答：你好，谢谢你的关注。2024 年前三季度，公司研发费用为 3.12 亿元。

5、问：针对前三季度的大额亏损，公司是否有计划调整业务结构或优化成本控制策略？

答：你好，谢谢你的关注。公司将深化精益管理，持续控费提效，优化产业结构，优化资产配置，同时推动彩电业务减亏控亏扭亏，半导体业务产业化的规模效益产出，推动白电业务及PCB业务的效益持续提升，从而进一步改善主营业务盈利能力。

6、问：深康佳A的白电业务在 2024 年表现如何？是否有新的产品线或市场扩展计划？

答：你好，谢谢你的关注。2024 年公司白电业务的主要工作如下：1、强化高端化产品思维：（1）围绕原鲜、除菌、新风、智慧洗、消毒，提升核心技术竞争力和产品能力，加大中高端产品布局；（2）坚持品质驱动，以满足用户实际需求为本，提升产品品质，提升用户体验；（3）坚持高毛利导向，以毛利总额最大化为导向，引领产品迭代创新，实现上量产品有毛利，高毛利产品要上量。2、纵深推进精益制造：（1）加快打造“智能车间”；（2）围绕UPPH（人均时产能）提升，从工序的源头到交付，沿着“产销协同、消除浪费、持续改善、精益求精”的目标，加速实现流程精益化、成本工艺化、管理数据化、体系标准化。3、加快海外运营体系建设：（1）全方位提升海外销售队伍水平，健全配套的激励机制；（2）集中优势资源，深耕产粮区优势市场，开拓空白机会市场；（3）聚焦核心客户的深度战略合作，从产品开发、信保额度、销售定价上给予政策倾斜；（4）统筹海外产品线规划，对标竞品，加大研发和新品投入，2 年内建立比较齐整的外销全品类产品线。

7、问：请公司介绍一下各个半导体和智能创新科技园区的进度以及预计投产时间？

答：你好，谢谢你的关注，关于公司半导体业务的进展情况请关注公司的定期报告。

8、问：针对滚筒洗衣机项目的投资，公司预计何时能够实现盈利，

该项目对公司整体业绩的预期贡献是多少？

答：你好，谢谢你的关注。对于康佳智能滚筒生产线项目，公司会在充分考虑市场环境、竞争态势、自身优劣势等因素后审慎决策，并根据项目的进展情况以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《康佳集团股份有限公司章程》的要求，履行相应的审批流程，并按照相关要求信息进行信息披露。

9、问：贵公司是老牌央企，在央企改革方面，在消费电子和半导体有什么规划？

答：你好，谢谢你的关注。公司制定了“一轴两轮三驱动”的新发展框架，其中“一轴”是主业定位，以电子科技产业为发展轴心，致力于发展成为具有全球竞争力的世界一流电子科技企业集团；“两轮”是发展主线，以消费电子、半导体为发展主线，致力于建立并巩固具有核心壁垒的业务根据地；“三驱动”为业务模式，以产品业务、制造业务、国际业务为主引擎，形成定位清晰、优势互补、协同并进的长效发展模式。

10、问：公司在2024年是否有计划进行资本运作，如增发、配股等，以筹集资金支持业务发展？

答：你好，谢谢你的关注。如果未来有相关事项，公司将按照相关程序审议并严格履行信息披露义务，具体请以公司公告为准。

11、问：市值管理及提振股价计划

答：你好，谢谢你的关注。公司正积极学习、研究《上市公司监管指引第10号——市值管理》等政策，若有相关计划，公司将根据相关法律法规，及时进行信息披露。

12、问：请介绍下公司彩电代工业务情况？

答：你好，谢谢你的关注。公司在安徽滁州、广东东莞等地有多个生产基地，拥有先进的生产设备和成熟的产线管理经验。公司一直在积极开拓代工业务，有稳定的合作伙伴。

13、问：公司PCB业务主要发展方向是什么？

答：你好，谢谢你的关注。公司PCB业务将进一步加快业务规模增长，改善产品结构，从现在的产品线向多层板、HDI（高密度互连技术）板、FPC（柔性线路板）板拓展，改善PCB产品的产品结构，实现产品多元化、

高端化。

14、问：康佳A在 2024 年采取了哪些具体措施来改善经营状况和提升业绩？

答：你好，谢谢你的关注。公司立足长远，深化专业化整合，实施精益管理，开展提产盘活，并把资源用于保障主业发展，聚焦资源推动白电及PCB产业的规模增长和利润提升，精益管理推进彩电业务的价值经营和减亏控亏，创新实施半导体业务的资本化及效益化产出，积极改善经营业绩。

15、问：B股目前跟A股价格差距太大，请问公司后续有啥计划整改该局面，提升B股价格？

答：你好，谢谢你的关注。公司将积极研究相关政策，如有相关计划，请关注公司公告。

16、问：公司在 2024 年的半导体业务布局方面有哪些新的进展或投资计划？

答：你好，谢谢你的关注。公司半导体业务将以成本市场化倒逼科研突破，加速实现产业规模化效益，具体措施如下：1、以市场成本倒逼技术突破：公司将以市场需求为导向，以产品市场化成本为依托，以产业经营盈利为目标，系统盘点光电半导体产业链条及技术链条，优化不能降低产品成本的制造工序，停止不能压降成本及提升产品价值的研发项目，将资源腾挪聚焦至能压降成本及提升溢价的关键核心技术中去，以市场需求及经营盈利倒逼技术突破，聚力拓展出一批稳定的合作客户。2、加速推动产业化进程：（1）聚焦大客户销售攻坚，通过规模化量产，优化工艺、降低成本，实现Mini LED商显产品的规模化销售、存储封测产品的规模化加工和SMT封装贴片产品的规模化制造；（2）开展巨量转移技术良率与效率攻坚，攻克激光转移技术，提升芯片微小化显示技术能力；（3）利用产业资源为光电半导体产业化提供供应链资源、技术资源及订单资源，进一步推动光电半导体产业化进程。

17、问：请问公司如何评估其在PCB产业中的竞争力，未来在这一领域有哪些发展策略？

答：你好，谢谢你的关注。公司PCB业务以高端化升级为原则，提升产品结构，打造高端制造工艺水平，聚焦高毛利客户，通过高端制造、高端产品和高端客户的打造，进一步提升经营业绩。

	<p>在短期内，（一）推动产品从硬板向软板及软硬结合板、从多层板向超多层板进行结构性升级；（二）调整客户结构，推动客户群体升级，加强重点客户和战略客户开拓。</p> <p>中长期，推进产品层次升级，从基板向载板升级，实现金属基板、多层板、软板、软硬结合板及HDI（高密度互连技术）全品类产品覆盖。</p>
附件清单	无
日期	2024年12月12日